

## ●LSI 事業戦略説明会 (IR) 質疑応答議事録

日時 : 2009 年 8 月 27 日 (木) 16 : 00~17 : 30  
場所 : 富士通株式会社 本社事務所 24 階大会議室  
説明者 : 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社  
代表取締役社長 岡田 晴基  
取締役 執行役員副社長 藤井 滋  
取締役 執行役員副社長 小原 恒明

### 質問者A

- Q. 富士通マイクロエレクトロニクス (以下、FML) の課題と強みは何ですか。
- A. (岡田)商品力を強くしていく必要があります。お客様に価値のあるソリューションを提供できなければ企業として存続できません。これまでは先端分野に大型投資を行うモデルでビジネスを進めてきましたが、その結果、厳しい環境の中で人や設備の余剰感が大きくなりました。そこで、ファブライトモデルへの転換を進め、ラインの統廃合、人員の再配置を行い、固定費を徹底的に削減し、最適化された工場を使い切る方針に大きく舵を取りました。その結果、下期は益転の可能性も出てきました。商品力強化に向けて、4 つの領域に注力していきます。今後は個々の技術を組み合わせることにより、強いソリューションを提供していくことで、2012 年度から 2014 年度にかけて平均 8%の営業利益率を達成できると考えています。
- Q. 富士通グループ内における半導体事業の位置付けはどうなっていますか。また、どのように富士通グループに対して貢献していくことができますか。
- A. (岡田)残念ながら、長らく半導体事業は赤字になっており、黒字化が喫緊の重要課題です。現在の厳しい状況をチャンスと捉え、事業モデル、費用構造、商品ポートフォリオにおいて大きな改革をしました。これは FML が単独で利益を出し続ける会社になるためです。また、富士通の製品に対しては、最先端の LSI を供給することで貢献していきます。
- Q. 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー(以下、TSMC)とは対等なパートナーシップを築いていけるのでしょうか。
- A. (岡田)単純なファンドリモデルではありません。IP の共有化も視野に入れて 28nm プロセスを共同開発し、FML が強みを持つパッケージに関する共同開発も検討しており、互いにメリットのある提携であると考えています。ご存知の通り、1 年前までは競争相手でした。しかし、交渉を重ね将来を見据えたパートナーシップを構築できました。お客様のためになるコラボレーションモデルと考えています。また、TSMC がグローバルに持つメジャーな顧客に対して、グローバル ASIC モデルを一緒にやらないかという話をしています。
- Q. 2012 年度から 2014 年度は、2008 年度と比べて費用構造がどのように変化していますか。
- A. (岡田)2008 年度に、三重工場第 2 棟は約 500 億円の減損処理をし、三重工場全体の償

却はかなり進みました。また岩手工場、会津若松工場についても償却が進んでいます。今後は最適な規模に縮小した工場を徹底的に使い切って利益を出します。研究開発費の売上に対するレベルはまだ高いと認識しており、今後、先端プロセス投資から商品力強化に向けた投資へとシフトさせていきながら、売上の規模にあった水準にしていきます。

商品力強化と費用削減により中期目標の推移イメージは、2010年度は営業利益 100 億円で営業利益率約 3%、2011年度は同 150 億円以上で同約 5%、その後 2012年度は営業利益率約 6%、2013年度に同約 8%、14年度に同約 10%を想定しています。売上目標は、2009年度 2900 億円、2010年度 3100 億円、2011年度以降 2014年度に向けて 3400 億円程度の伸びを想定しています。

#### 質問者 B

Q. 新規開発を縮小または凍結する 6 つの領域について、そのような判断に至った理由をそれぞれ教えてください。

A. (岡田)基本的には赤字事業であったということです。リソースは限られているので、事業を「やめる」「伸ばす」「新たに創造する」の 3 つの分野に分け、儲からない事業についてはやめる、という判断をしました。もちろん、既存のお客様には継続的にサポートを行っていきますし、時間をかけ、適切なステップを踏みながら徐々に終息させていく予定です。継続する他の領域については、将来的にそのマーケットが広がったとしても、FML のコア技術がそのマーケットのニーズに合致することを条件として判断しました。

Q. それらの 6 つの領域が赤字になった背景を教えてください。

A. (岡田)赤字になった理由は、想定していたほどマーケットが伸びなかったなど、色々な要素があり一概には言えませんが、リソースが限られている中で、色々な分野にチャレンジし過ぎたということはあると思います。

Q. 2008 年度に減損した三重工場の製造面における競争力はどのようなレベルにあるのでしょうか。

A. (藤井)90nm プロセスラインはすでに減価償却がほぼ終了しており、コスト構造ならびに規模、テクノロジー共に、グローバルでも十分に戦える体制だと思っています。65nm プロセスラインについては、当初予定していた製造能力である月産 25,000 枚の半分以下しか製造できておらず、今回減損するに至りました。

Q. TSMC の工場と FML の三重工場はどう使い分ける予定ですか。

A. (藤井)45nm プロセスまでは FML、40nm プロセス以降は TSMC の工場を使います。45nm までは、IP やライブラリなども含めたトータルコストおよび性能において、FMLの方が TSMC より優位性を発揮できると認識しています。

#### 質問者 C

Q. TSMC との提携に関し、将来的な発想としてグローバル ASIC モデルという考え方もあるという説明がありましたが、従来、ASIC は IDM モデルという考え方が主流でした。

そのような中で敢えてファブレス ASIC モデルを生み出していこうと考える背景と、そのモデルで成功を収める上で何がポイントとなるのか教えてください。

- A. (岡田)2 年ほど前まで、ASIC の COT 事業は非常に力を入れて拡大を図ってきた分野でしたが、現在では 40nm 以降の製造ラインは持たないと表明していることから分かるように、撤退せざるを得ない分野になってきています。一方で、ASIC 事業そのものは FML の利益の源泉となっており、またテクノロジーのコアにもなっているという事実もあります。現在の国内市場を考えた場合、今後 ASIC の市場は相当厳しいと見ていますが、40nm プロセス、28nm プロセス共に TSMC の能力を活用することで、国内での ASIC 事業は成り立っていくだろうと思っています。そしてその先を見据えた時に、私は日本からグローバルへと展開していくという発想もあると思い、グローバル ASIC モデルという考え方をご紹介させていただきました。それを成功に導くために重要となってくるのは、我々の持つ強い IP やお客様のサポート力と、TSMC の持つグローバルなカスタマーベースをうまく組み合わせることができるかどうかだと考えています。

Q. 損益がブレイクイーブンとなる稼働率は何の程度でしょうか。

- A. (岡田)80%以上の稼働率にならないと、なかなか利益を生み出すことはできないだろうと考えています。2009 年度の第 2 四半期では、先端製品ライン(90nm および 65nm プロセスライン)の工場稼働率は 80%台に回復するものと見ており、下期は 80%台半ばを見込んでいます。一方、基盤製品ライン(90nm プロセス以前のライン)は、第 2 四半期は 70%台になるものと見ており、下期には 80%以上になるものと見込んでいます。

Q. 仮に現状の製造ラインがフル稼働となり、さらなる増強が必要となった場合にはどのように対応するのか、考え方を教えてください。

- A. (岡田)設備投資はできる限り絞り、最大でも 200 億円程度まで抑えていきたいと思っています。またその投資対象も、製造能力の増強投資ではなく、既存の製造設備の維持に限定していく方針です。

Q. マイコン事業について、16 ビット製品だけは縮小し、32 ビット製品と自動車向けだけは継続していくとのことでしたが、コアだけを外部から調達し、16 ビット製品の延命を図るという考え方はないのでしょうか。

- A. (藤井)16 ビットの汎用マイコンの撤退については、ローエンド品である 8 ビットとデジタル AV や白物家電を中心に 32 ビットのハイエンド品に需要そのものがシフトしてきており、16 ビットの製品に対しての需要が無くなってきていることが主な背景です。また、FML 自身の 16 ビット汎用マイコン市場でのポジションがあまり強くなかったということもあります。ただ、車載向けの CAN マイコンについては、元々高いシェアを持っているため、16 ビットも含めてフルラインナップでビジネスを展開していきます。

外部の IP を利用していくかどうかについては、アプリケーションに応じて適宜判断していきます。

#### 質問者 D

Q. 今回説明のあった注力分野で、2013 年度までに 08 年度比 1000 億円以上の売上拡大を

計画されていますが、一方で事業縮小または撤退する分野もあると伺いました。売上増減の内訳について教えてください。また、注力分野について非常に高い売上目標のように見えますが、具体的にどのように売上を増やしていくのですか。

- A. (岡田)内訳の詳細については開示を控えさせていただきますが、売上を伸ばす分野は注力4分野になります。一方、COTは今後減少していくと思われまます。また、グローバルでのASIC事業についてはこれから伸ばしていく分野ですが、すぐに増えていくとは考えていません。

注力分野の売上拡大ですが、映像機器分野は当社が得意としている領域であり、今回の目標が決して高いとは思いません。また、それ以外で大きく伸ばそうとしているのが、モバイル/エコロジー分野です。この領域は新しいビジネス領域として最も注力する分野で、積極的にリソースを投入していく予定です。新しい領域に対する未知数はありますが、将来の成長を考えると決して高い目標とは考えていません。

- Q. 窒化ガリウムの商用化にあたり、パワーデバイスのどの容量帯をターゲットにしているのですか。また、ウェハ等のコストについてどのようなプランニングをしていますか。

- A. (藤井)まだ商用化に向けて目処が立ちつつある段階で、量産化についてはこれから色々と検討していきます。容量帯については、現状のモバイルの電源系LSIビジネスの延長線が一つのターゲットであり、ここは数十ボルトの激戦区です。この分野は、販売子会社である富士通エレクトロニクスが持つお客様に対してビジネスを展開していけると考えています。それ以外では、自動車関連の分野も期待できる市場だと考えています。

- Q. 国内の同業他社から協業等の誘いがあった場合、富士通としてはどういった対応が考えられますか。

- A. (岡田)仮定のお話しにはお答えしかねます。今はFMLが1社単独で黒字化することが最重要課題と考えています。将来、他社と組むことがあるかもしれませんが、まずは自社が黒字化しないと、他社との交渉もできないと考えています。

#### **質問者 E**

- Q. 先端製品の製造能力である月産18,000枚の内、90nmプロセスと65nmプロセスの比率を教えてください。また、45nmプロセスまでは自社工場で製造するとのことですが、具体的にどの程度の製造能力になるのか教えてください。

- A. (岡田)90nmプロセスと65nmプロセスの比率については非公表とさせていただきます。45nmプロセスについては、製造ラインを構築しますが、富士通のサーバ向けなので限られた製造能力になります。40nmプロセス以降についてはTSMCに委託します。

- Q. 今後微細化が進む中で、現在65nmプロセスの顧客がTSMCに委託する40nmプロセスに移行した際、FMLの稼働率は下がるのでしょうか。また、現在200mmウェハの製造ラインで作っている製品も、早い段階で今後300mmウェハへ移行していくのでしょうか。

- A. (岡田)65nmプロセスラインは、お客様の所要が多く現在フル稼働です。また、それほ

ど大きな製造能力を持っている訳ではないので、65nm プロセスラインの稼働率が下がるといことは想定していません。

(藤井)古いテクノロジーの製造ラインは、微細化が進んだ時にそれを埋める製品が必要になります。それを埋める製品としては、今回ご説明させていただいた窒化ガリウムやフラッシュマイコンが挙げられます。フラッシュマイコンは、お客様によってフラッシュ容量も様々なものを求められており、180nm、90nm プロセスなど様々なプロセステクノロジーで対応しています。

また、RF などアナログリッチなものもあり、全ての製品が 300mm ウェハに移行する訳ではありません。180nm プロセスや 90nm プロセスまでは微細化のスピードも速かったのですが、最近では微細化のスピードも緩まっており、さらなる微細化を必要としない製品も増えてきています。

以 上